



出展の
ご案内

2025.6.4 Wed. → 6 Fri.

東京ビッグサイト東展示棟
Tokyo Big Sight, East Exhibition Halls

電子機器2025
トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2025

出展申込受付開始

2024年11月1日(金) 10:00～



[展示会公式サイトへ](#)

主催：一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、
一般社団法人日本ロボット工業会
共催：電子デバイス産業新聞【(株)産業タイムズ社】、電線新聞【(株)工業通信】、
全国電子部品流通連合会／東京都電機卸商業協同組合、株式会社織研新聞社、
後援（予定）：経済産業省

海外協力：世界電子回路業界団体協議会（WECC）加盟団体
中国電子回路行業協會（CPCA）、欧州電子回路協會（EIPC）、インド電子工業會（ELCINA）、
香港線路板協會（HKPCA）、米國電子回路協會（IPC）、インド電子回路工業會（IPCA）、
韓國電子回路産業協會（KPCA）、タイ電子回路工業會（THPCA）、
台灣電路板協會（TPCA）

Association of Electronic Industries in Singapore(AEIS)
Korea Packaging Integration Association(KPIA)

2024/10/10版

エレクトロニクスの機能を具現化する 全てがココにある!!

最先端の電子回路基板、実装、装置、プロセス、そして電子部品を誇る400社(予定)が集い、
世界最高峰の技術に触れる機会をご提供いたします。

開催概要

会期 2025年6月4日(水)～6日(金) 午前10時～午後5時

会場 東京ビッグサイト 東展示棟

本部事務局 一般社団法人 日本電子回路工業会(JPCA)

入場料 1,000円(税込) ※WEB登録で無料

運営事務局 株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ(JCSC)

最先端のアプリケーションに関する企画を多数開催

電子回路基板、実装、関連装置、材料／プロセス、自動運転向け高速伝送技術、EV向け大電流技術、アドバンスドパッケージング技術、
パワー半導体・ガラス基板向け材料／プロセス技術、気候変動対策に寄与する低エミッション技術、E-Textile/Wearable技術、等

構成展示会・出展対象

電子回路技術	高密度実装技術	電子部品実装技術
 JPCA 2025 Show 第54回国際電子回路産業展 ●プリント配線板技術展 電子回路基板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等) ●半導体パッケージング・部品内蔵技術展 モジュール基板／モジュール基板実装／部品内蔵基板・部品内蔵に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等) ●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア フレキシブルプリント配線板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等) ●機器・半導体受託生産システム展 EMS・ODM及び半導体の受託生産に関するサービス・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等) 主催：一般社団法人日本電子回路工業会	 JIEP 2025 マイクロエレクトロニクスショー 第39回 最先端実装技術・パッケージング展 実装・電子技術に関する技術全般 (材料／回路・実装設計／高速高周波／電磁特性／電子部品・実装／光回路実装／環境調和型実装／半導体パッケージ／マイクロメカトロニクス実装技術／各種関連製造装置、等) 主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会	 JISSO PROTEC 2025 第26回 実装プロセステクノロジー展 ■電子部品実装機および関連機器・システム：電子部品装着機(マウンタ)、電子部品挿入機(インサータ)、クリームはんだ印刷機、はんだ付け装置(リフローオープン)、ディスペンサ ■実装関連機器・システム：搬送システム、AGV、自動倉庫、テーピングマシン・材料、バルクフィーダ・その他フィーダ、自動組立装置、レーザーマーキング装置、洗浄装置・洗浄剤 ■半導体実装機・システム：ボンディング装置、フリップチップ実装システム、COBシステム ■産業用ロボット：ハンドリングロボット、組立ロボット、搬送ロボット、AMR ■検査・試験装置：基板外観検査装置 半導体製造関連検査・測定装置 ■実装設計システム：設計ツール生産最適化ソフトウェア、実装プログラミング装置 ■実装デバイス・部品および関連材料 ■実装デバイス包装材 ■実装接合システム・はんだ／接合材料 ■高周波対応装置・部品・材料 ■環境関連装置・材料 主催：一般社団法人日本ロボット工業会

AIデバイス	電気・光伝送技術	半導体・電子部品	高機能テキスタイル
 AI Device Expo AIデバイス展 スマートデバイス、スマートホームデバイス、ウェアラブルデバイス、ロボティクス用AIデバイス、産業用ロボット向けAIデバイス、自動運転技術、AIソフトウェアとプラットフォーム、バーチャルアシスタント、教育向けAI、医療AI、セキュリティAI、データ分析ツール、等 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電子デバイス産業新聞((株)産業タイムズ社)	 WIRE Japan Show 2025 電気・光伝送技術展 ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般(産業用機器／電線・ケーブル及びコネクタ／電線加工機／配線用部材／ワイヤーハーネス／電線・ケーブル用計測器／各種装置／検査技術／装置間(M2M)伝送／光伝送等) 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電線新聞((株)工業通信)	 Electronics Component & Unit Show JEP 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合 半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般(半導体／電子デバイス／センサー／機構部品／FA制御機器／計測器／電源／IoT・M2Mソリューション／もの作りソリューション・システム、等) 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合	 E-Textile/Wearable イーテキスタイル／ウェアラブル展 電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル(スマートテキスタイル／ストレッチャブル技術／ウェアラブル技術)に関する技術全般(繊維素材・材料／導電性素材・材料／編・織技術／プリント・マーキング技術／フィルム／センサー／信頼性検査／関連装置・システム、等) 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社織研新聞社

NEW 企画展の設置

車載エレクトロニクス展 車載用半導体に関連した製品・技術	チップレット展 最先端の半導体、パッケージ関連の製品・技術
メディカル・ヘルスケア展 医療機器、医療IT関連製品・技術	スタートアップ・新マーケット展 エレクトロニクス関連ベンチャー企業、E+ 農業、E+ 環境

2024年開催実績

会場

東京ビッグサイト 東展示棟 3～6ホール

出展規模

438社 / 1230小間

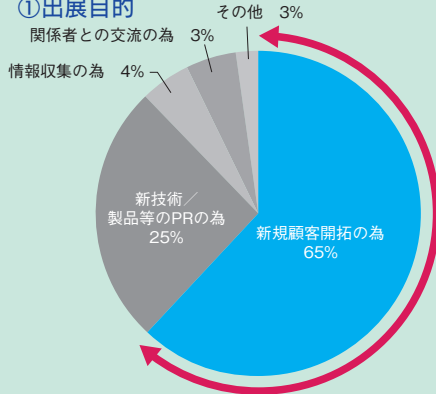
来場者数

48,334名

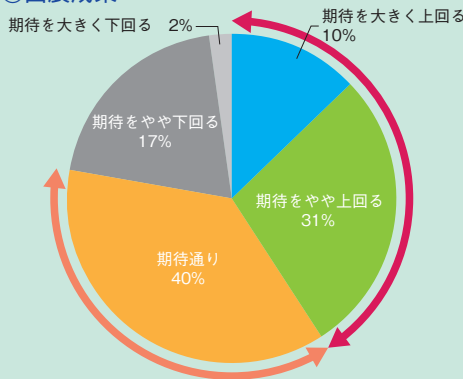
2024年展実績

● 出展者アンケート

① 出展目的

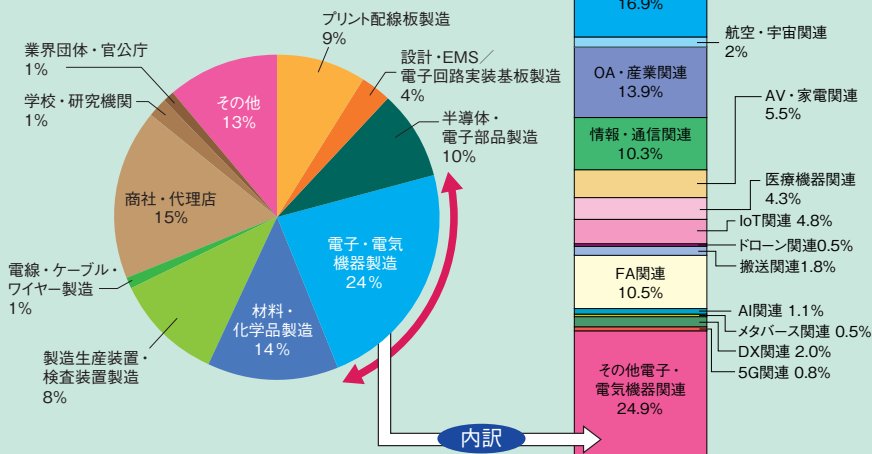


② 出展成果



新規顧客開拓を目的に出展し、41%の出展者は期待を上回る成果を、81%の出展者は期待通り以上の成果をあげる。

● 来場者業種分類



従来の電子・電気機器製造来場者にとどまらず、新しいアプリケーション分野の来場者層とのネットワークが期待できる。

注目 新しいネットワーク形成の場を提供

「学生ウェルカムブース」「交流プラザ」を設置し、エレクトロニクスの明日を担う若い世代を歓迎します！

「出展者交流会」を開催し、出展者間のネットワーキングを促進します！

来場実績

多種多様な業種・業界よりご来場！

半導体、通信、モビリティ(自動車、二輪車、自転車)、船舶、電車、航空機、農業、交通インフラ、ロジスティクス、ゲーム・玩具、メタバース、AI、AR/VR、各種システム・ソリューションプロバイダー、林業、水産業、食品、教育、医療／ヘルスケア、運輸、アパレル／スポーツ用品、金融、地方自治体、美容、スマート家電、防衛装備、e-Sports、AV、ドローン、ウェアラブル機器、センサー、防災、ロボット、バイオメトリクス、エネルギー、Dx/Gx/Cx/Sx、観光Dx、サイネージ、スマートx、等

AGC、Apple Japan、EIZO、JSR、JVC ケンウッド、KDDI、LG 電子グループ、LIXIL、NEC グループ、NTT グループ、Preferred Networks、Rapidus、SCREEN ホールディングス、SK Japan グループ、TDK、THK、TOPPAN グループ、TOTO、TSMC グループ、YKK、アイシン、アイリスオーヤマ、アサヒ飲料、アドバンテスト、アナログ・デバイス、アムコー・テクノロジー・ジャパン、アメリカ陸軍、アルプスアルパイン、いすゞ自動車、イビデン、インテル、ウシオ電機、オムロン、オリンパス、オリンパスメディカルシステムズ、カシオ計算機、キーエンス、キオクシア、キャノン、キャノン電子、キングジム、クボタ、クラレ、グンゼ、コニカミノルタ、サムスンディスプレイ、サムスングループ、サントリーホールディングス、シチズングループ、シャープ、ジャパンセミコンダクター、スズキ、スタンレー電気、セイコーグループ、ソシオネクスト、ソニーグループ、ソフトバンク、ダイキン工業、デンソーグループ、トヨタ自動車グループ、ニコン、ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング、ニトリホールディングス、ヌヴォンテック、ロジージャパン、パイオニア、パナソニックグループ、パラマウントベッド、ファナック、フジクラ、プリチストン、ボッシュ、マイクロン、ミネベアミツミ、ミライズテクノロジーズ、ヤマト運輸、ヤマハ、ヤマハ発動機、リコー、ルネサス エレクトロニクス、レゾナック、ロート製薬、ローム、旭化成、安川電機、伊藤忠商事、宇宙航空研究開発機構、機河電機グループ、沖電気工業グループ、花王、華為日本グループ、海上自衛隊、海上保安庁、丸紅、岩谷産業、京セラ、近鉄エクスプレス、熊谷組、菅野理、古河電気工業、江崎グリコ、在日米軍横田基地、三井物産、三菱自動車工業、三菱重工業グループ、三菱商事、三菱電機グループ、産業技術総合研究所、四国電力、資生堂、鹿島建設、芝浦メカトロニクス、住友商事、住友電気工業グループ、出光興産、商船三井ロジスティクス、小糸製作所、小森コーポレーション、小島プレス工業、信維通信日本、信越化学工業、NEDO、新光電気工業、神戸製鋼所、西鉄物流、西日本高速道路エンジニアリング関西、西日本鉄道、積水化学工業、川崎重工業、双日、倉敷紡績、総合警備保障、村田製作所グループ、太平洋セメント、太陽誘電、大崎電気工業、大日本印刷、大分キャノン、大林組、大和ハウス工業、竹中工務店、中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京、朝日新聞社、長瀬産業、長谷工コーポレーション、長野日本無線、帝人、電通、島津製作所、東レ、東レ・デュポン、東レエンジニアリング、東海理化、東海旅客鉄道グループ、東急建設、東京エレクトロングループ、東京電力グループ、東芝グループ、東日本旅客鉄道グループ、東北電力ネットワーク、東洋紡グループ、日産自動車、日清食品ホールディングス、日清紡グループ、日本 AMD、日本 ESG 産業協会、日本 HP、日本 IBM、日本シノプシス、日本ゼオン、日本たばこ産業、日本テキサスインスツルメンツ、日本経済新聞社、日本航空電子工業、日本通運、日本電気グループ、日本電信電話、日本郵政グループ、日野自動車、日立製作所グループ、任天堂、能美防災、農林水産省林野庁、浜松ホトニクス、富士フイルムグループ、富士急行、富士通グループ、富士電機、米軍横田基地、米国防務、豊田合成、豊田自動織機、豊田通商グループ、防衛技術協会、防衛省海上自衛隊、防衛大学校、本田技研工業グループ、味の素グループ、明電舎、野村総合研究所、野村證券、矢崎総業、理想科学工業、陸上自衛隊システム通信・サイバー学校(順不同・敬称略)

●海外来場者：27か国・地域から来場

出展料金

区 分		1小間 / 9m ²
一 般		496,100円 (税込)
会員企業*1	通常	423,500円 (税込)
	早期	396,880円 (税込)
	20小間以上	372,075円 (税込)

*1 対象：JPCA会員／JIEP正会員・賛助会員／JARA正会員・賛助法人会員／JEP・TEP正会員
※1小間のサイズは、3m×3m=9m²です。
※小間設営・装飾費、電気・給排水、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

出展申込 (2024年11月1日 (金) 10:00～より開始)

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。(www.jpccashow.com)
出展申込書を使用する場合は、メールもしくはFAXでお申込ください。
貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選び頂き、必ず、出展申込書裏面の「出展規約」をご確認ください。
専用の出展申込書が用意されている展示会については、当該の出展規約が適用されます。
出展申込書を受理後、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします(原則会期前振込)。請求書は出展者専用webよりダウンロードをお願いします。

申込締切

早期申込締切日 (対象：会員企業)	2025年1月31日 (金)
最終申込締切	2025年2月28日 (金)

※早期料金・対象については出展料の欄をご確認ください。
※予定の小間数に達した場合、締切らせて頂きます事を予めご了承ください。

取消料

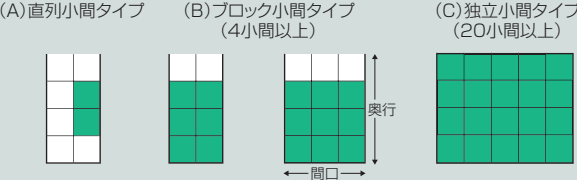
出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
～2月28日 (金)	小間料金の 30%
3月1日 (土)～3月31日 (月)	小間料金の 50%
4月1日 (火)～4月30日 (水)	小間料金の 70%
5月1日 (木)～	小間料金の100%

開催までのスケジュール

2024年11月	2025年1月	2月	3月	4月	5月	6月
▲ 11月1日 (金) 10:00～ 出展申込受付開始	▲ 1月31日 (金) 出展早期申込締切 (対象：会員企業)	▲ 2月28日 (金) 出展最終申込締切	▲ 3月中旬 出展者説明会開催 出展マニュアルの公開 ▲ 3月下旬 小間位置選択会開催	▲ 4月中旬 招待状発送 来場登録開始		▲ 6月2日 (月)～3日 (火) 搬入期間 6月4日 (水)～6日 (金) 展示会開催 ※最終日即日撤去
3月中旬～随時 各種提出書類期限						

小間形態



※小間タイプのご希望に添いかなる場合もありますので、予めご了承ください。

小間位置の決定

小間位置選択会(2025年3月下旬開催予定)にて小間位置を決定いたします。
原則、同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、出展申込順で選択順位を決定します。
※詳細は出展規約をご確認ください。

出展者サポートプログラム

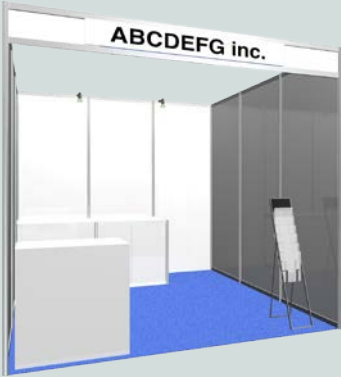
有料・オプション

来場者データ取得サービス、各種広告プラン等 出展の効果を高めるプログラムをご用意します。
※詳細は別途出展者説明会(2025年3月中旬開催予定)でご案内します。

パッケージブースプランのご案内

有料・オプション

●1小間ベーシックプラン
価格(予定)：¥121,000 (税込)
最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。詳細は出展者説明会(2025年3月中旬開催予定)にて配布する資料をご確認ください。



本部事務局

一般社団法人 日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階
TEL：03-5310-2020 FAX：03-5310-2021 E-mail：show@jpca.org

運営事務局

株式会社ジェシーエス・コミュニケーションズ(JCSC)
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-10 四国第二ビル
TEL：03-5931-0039 FAX：03-3293-0505 E-mail：jpcashow@jcs-c.com



展示会公式サイトへ